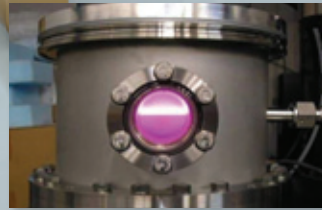




イソラスト PureFab™ JPF10



有機系材料のみで構成される高温半導体製造プロセス用シール材料

イソラスト PureFab™ JPF10は、有機系材料のみで構成された最も過酷な半導体製造プロセス用のパーフロロエラストマー材料です。

NF₃を含む様々なプラズマ耐性に加え、過酷なプロセスや+300℃(+572 °F)を超える高温環境下であっても優れた真空シール性を発揮する材料となっています。

イソラスト PureFab™ JPF10は、パーティクル発生が低く、アウトガス特性に優れているため、半導体製造プロセスの歩留まり向上とトータルコストの低減に貢献します。

特長

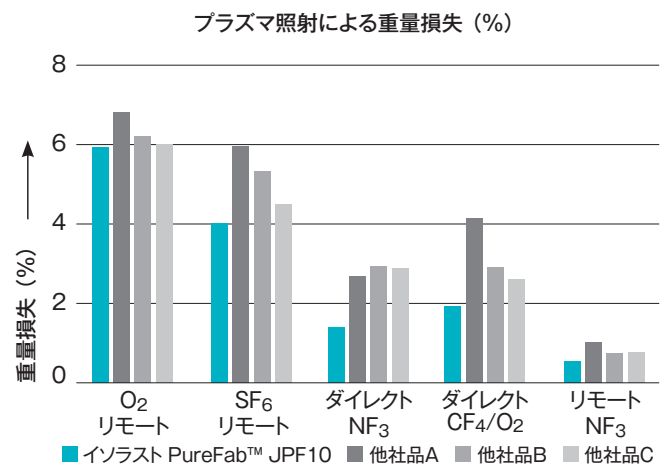
- 有機系材料のみの高純度材料
- +300 °C(+572 °F)を超える環境でも大変優れた熱安定性
- アミン系プロセス薬品に対する優れた耐性
- 独自の架橋技術により、シール性を保持しながら低い圧縮永久歪み特性を示す
- 優れたシール性
- 一般的なプロセスガス中での優れたプラズマ耐性
- 大変低いアウトガス
- 最大使用温度は+310 °C(+590 °F)

主な用途

- 成膜プロセス:PECVD、HDPCVD、PEALD
- エッチングプロセス:ALE、ドライエッチング
- チャンバーのリッドシール
- ガス インレット部のシール
- スリットバルブのドア用シール

耐プラズマ性

下記の試験結果から、他社製品よりもイソラスト PureFab™ JPF10は、重量損失が低く、優れた耐プラズマ性を示します。

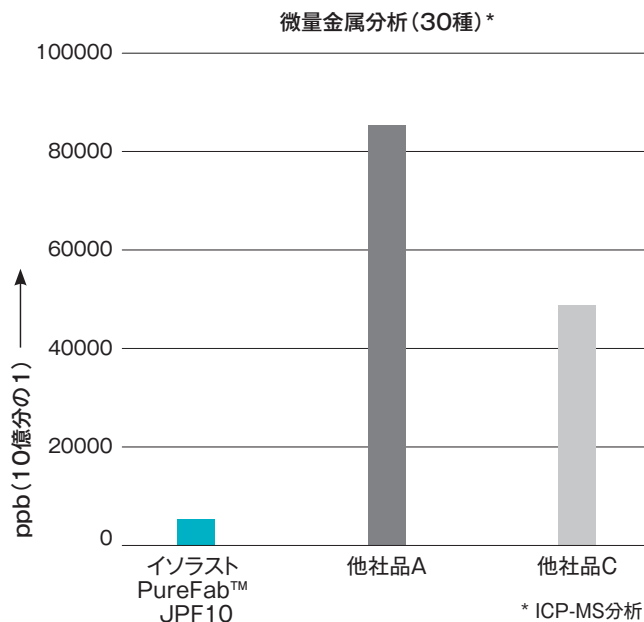


イソラスト PureFab™ JPF10

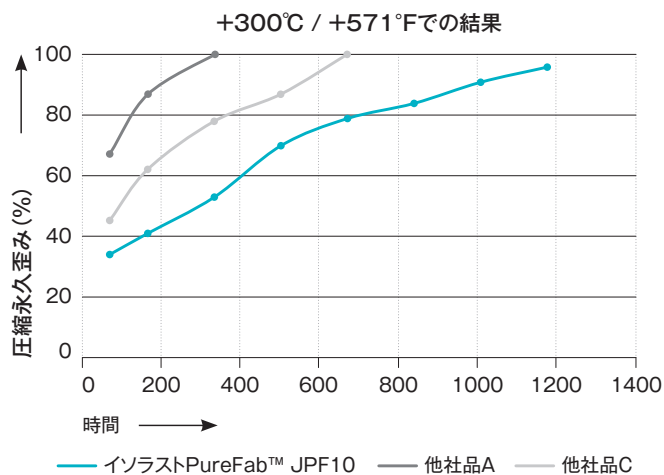
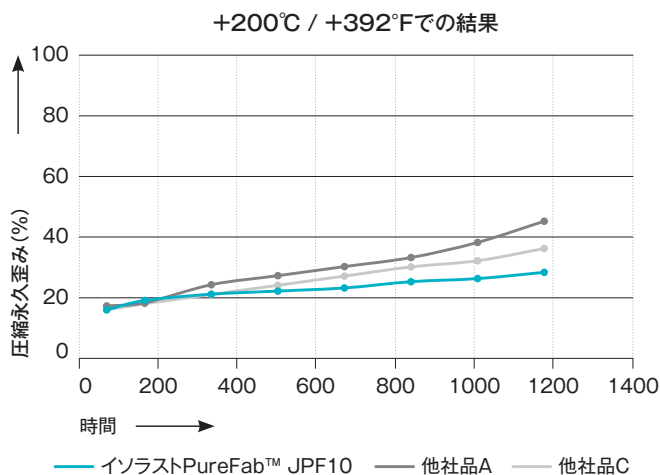
一般データ	JPF10
エラストマータイプ	FFKM
色	薄茶色

パラメータ	試験方法	結果
硬度 (Shore A)	D2240	65
引張り強さ (MPa)	D1414	8
破断伸び (%)	D1414	270
100%モジュラス (MPa)	D1414	2.2
圧縮永久歪み (%)		
72h @+200 °C/+392 °F		14
72h @+250 °C/+482 °F	D395	23
72h @+300 °C/+572 °F		34
連続運転時の最高使用温度		~+310 °C /+590 °F

純度



圧縮永久歪み



トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、数十年にわたるエンジニアリングとアプリケーションの経験に加えて、過酷な半導体製造プロセス向けの高精度でカスタマイズされたシール製品の設計に関する最新の知識を提供します。

イソラスト PureFab™ シリーズは、プラズマや高温環境下において最高クラスの高純度をほこるシール性能を実現し、プロセス薬品、アプリケーション、複雑な半導体製造プロセスの要求項目にお応えするため、用途ごとに独自の材料をそろえています。

各国ごとの営業員と半導体業界専門の社員、そしてグローバルでのサポートという3つの柱により、設計、試作品提供、そして量産にいたるまでシール業界トップクラスのサービスを提供いたします。このサービス体制に加え、様々なデジタルツールを提供しており、お客様の業務効率向上に貢献しています。



詳細な情報やご連絡先については上記のQRコードをスキャンいただくか下記弊社Webサイトをご覧ください。
www.tss.Trelleborg.com/jp



WWW.TSS.TRELLEBORG.COM/JP

日本 トレルボルグ シーリング ソリューションズ 株式会社
東京:03-5633-8008 大阪:06-6821-0077 名古屋:052-212-5731